



Dell™ Studio XPS™ 8000 - Umfassende technische Daten

In diesem Dokument finden Sie Informationen technischer Art, die Sie möglicherweise beim Einrichten und Aufrüsten des Computers oder beim Aktualisieren von Treibern benötigen.

ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie, indem Sie auf **Start**  **Hilfe und Support** klicken und die Option zum

 Anzeigen von Informationen über Ihren Computer auswählen.

Prozessor	Systemplatinenanschlüsse
Laufwerke und Geräte	Externe Anschlüsse
Speicher	Erweiterungssteckplätze
Computerinformationen	Stromversorgung
Erweiterungsbuss	Batterie
Video	Abmessungen und Gewicht
Audio	Umgebung
Speicherkartenleser	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt. In diesem Dokument verwendete Marken: *Dell*, das *DELL*-Logo und *Studio XPS* sind Marken von Dell Inc.; *Intel* ist eine eingetragene Marke und *Core* eine Marke der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern; *Blu-ray Disc* ist eine Marke der Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc., die von Dell unter Lizenz verwendet wird.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Modell: D03M-Serie

Typ: D03M001

August 2009

Rev. A00

Prozessor

Typ	Intel® Core™ i7-870 Intel Core i7-860 Intel Core i5-750
L1-Cache	32 KB
L2-Cache	256 KB
L3-Cache	8 MB

[Zurück nach oben](#)

Laufwerke und Geräte

Extern zugänglich	<ul style="list-style-type: none"> zwei 5,25-Zoll-Laufwerkschächte für SATA DVD+/-RW-Super-Multi-Laufwerk oder Blu-ray Disc™-Kombination oder optisches Blu-ray-Disc-RW-Laufwerk ein 3,5-Zoll-Schacht für ein Flexdock und ein Bluetooth®-Modul
-------------------	---

Wireless (optional)	WiFi/Bluetooth® Wireless-Technologie
Intern zugänglich	zwei 3,5-Zoll-Laufwerkschächte für SATA-Festplatten

[Zurück nach oben](#)

Speicher

Anschlüsse	vier intern zugängliche DDR3-DIMM-Steckplätze
Modulkapazitäten	1 GB, 2 GB und 4 GB
Speichertyp	1066-MHz oder 1333 MHz DDR3 DIMM; nur Nicht-ECC-fähig
Mögliche Speicherkonfigurationen	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB und 16 GB (64-Bit-Betriebssystem)

[Zurück nach oben](#)

Computerinformationen

System-Chipsatz	Intel P55
Datenbusbreite	2,5 GT/s
DRAM-Busbreite	64 Bit
Adressbusbreite (Prozessor)	64 Bit
RAID-Unterstützung (nur interne SATA-Laufwerke)	RAID 0 (Striping) RAID 1 (Datenspiegelung)
BIOS-Chip (NVRAM)	8 MB
Speichergeschwindigkeit	1333 MHz

[Zurück nach oben](#)

Erweiterungsbus

PCI Express	<ul style="list-style-type: none"> • Gen2x1-Steckplatz mit bidirektionaler Geschwindigkeit — 500 MB/s • Gen2x16-Steckplatz mit bidirektionaler Geschwindigkeit — 16 GB/s
PCI	32-Bit-Geschwindigkeit — 33 MHz
SATA 2.0	1,5 GBit/s und 3,0 GBit/s
USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Geschwindigkeit — 480 MBit/s

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Volle Geschwindigkeit — 12 MBit/s • Geringe Geschwindigkeit — 1,2 MBit/s |
|--|---|

[Zurück nach oben](#)

Video

Separat	PCI Express x16-Karte
---------	-----------------------

[Zurück nach oben](#)

Audio

Typ	Integriertes 7.1-Kanal-, High-Definition-Audio mit S/PDIF-Unterstützung
-----	---

[Zurück nach oben](#)

Speicherkartenleser

Unterstützte Karten	<ul style="list-style-type: none"> • CompactFlash (CF)-Karte • Smart Media (SM)-Karte • xD-Picture (xD)-Karte • Memory Stick (MS)-Karte • Memory Stick PRO (MSPRO)-Karte • Memory Stick PRO HG (MSPRO HG)-Karte • SecureDigital (SD)-Karte • SecureDigital (SDHC) 2.0-Karte • Multimedia-Karte (MMC) • MicroDrive (MD)
---------------------	--

[Zurück nach oben](#)

Systemplatinenanschlüsse

Speicher	Vier 240-polige Anschlüsse
PCI	Ein 124-poliger Anschluss
PCI Express x1	Zwei 36-polige Anschlüsse
PCI Express x16	Ein 164-poliger Anschluss
Stromversorgung (Systemplatine)	Ein 24-poliger 12 V-EPS-Anschluss (ATX-kompatibel)
Prozessorlüfter	Ein 4-poliger Anschluss
Gehäuselüfter	Ein 3-poliger Anschluss

USB-Anschluss auf der Vorderseite	Fünf 9-polige Anschlüsse
Audioanschluss auf der Vorderseite	Ein 9-poliger Anschluss für 2-Kanal-Stereo-Sound und Mikrofon
SATA	Vier 7-polige Anschlüsse
S/PDIF-Ausgang	5-poliger Anschluss

[Zurück nach oben](#)

Externe Anschlüsse

Netzwerkkartenanschluss	RJ45-Anschluss
USB	zwei oberseitige, zwei vorderseitige und vier rückseitige USB 2.0 kompatible Anschlüsse
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • oberer Bereich - Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon • Rückseite - sechs Anschlüsse für 7.1-Unterstützung
S/PDIF	Ein S/PDIF-Anschluss (optisch)
eSATA	Ein Anschluss an der Rückseite
IEEE 1394a	Ein 6-poliger serieller Anschluss an der Rückseite

[Zurück nach oben](#)

Erweiterungssteckplätze

PCI	
Anschlüsse	Einer
Anschlussgröße	124-poliger Anschluss
Anschluss-Datenbreite (max.)	32 Bit
PCI Express x1	
Anschlüsse	Zwei
Anschlussgröße	36-poliger Anschluss
Anschluss-Datenbreite (max.)	1 PCI Express-Lane
PCI Express x16	
Anschlüsse	Einer
Anschlussgröße	164-poliger Anschluss
Anschluss-Datenbreite (max.)	16 PCI Express-Lane

[Zurück nach oben](#)

Stromversorgung

Gleichstrom-Netzteil	
Leistung	350 W
Maximale Wärmeabgabe	1836 BTU/h
ANMERKUNG: Die Wärmeabgabe wird anhand der Nennleistung der Stromversorgung bestimmt.	
Eingangsspannung	115/230 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nenn-Ausgangsstrom	8 A/4 A
Knopfzellenbatterie	Lithium-Knopfzellenbatterie (3V, Typ CR2032)

[Zurück nach oben](#)

Batterie

Knopfzellenbatterie	Lithium-Knopfzellenbatterie (3V, Typ CR2032)
---------------------	--

[Zurück nach oben](#)

Abmessungen und Gewicht

Höhe	407,75 mm
Breite	185,81 mm
Tiefe	454,67 mm
Gewicht	10,18 kg

[Zurück nach oben](#)

Umgebung

Temperaturbereich:	
Betrieb	10 °C bis 35 °C
Bei Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 % (nicht-kondensierend)
Zulässige Erschütterung (erzeugt durch ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert):	
Betrieb	0,25 G Effektivbeschleunigung (GRMS)
Bei Lagerung	2,2 G Effektivbeschleunigung

	(GRMS)
Zulässige Stoßeinwirkung (gemessen mit Kopf der Festplatte in Parkstellung und einer halben Sinuswelle von 2 ms):	
Betrieb	Halbsinus-Impuls: 40 G für 2 ms mit einer Änderung der Geschwindigkeit von 51 cm/s
Bei Lagerung	Halbsinus-Impuls: 50 G für 26 ms mit einer Änderung der Geschwindigkeit von 813 cm/s
Höhe über NN (maximal):	
Betrieb	-15,2 bis 3048 m
Bei Lagerung	-15,2 bis 10 668 m
Luftverschmutzungs-kategorie	G2 oder geringer gemäß ISA-S71.04-1985

[Zurück nach oben](#)